

株式会社アドバンテスト
2008年度 決算報告

2009年4月27日

取締役 常務執行役員 栗田 優一

業績概要および予想との比較

ADVANTEST.

(単位：億円)	2007年度	2008年度		予想 (2月25日)
			前年度比(%)	
受注高	1,622	501	-69.1	—
売上高	1,828	767	-58.1	750
営業利益	227	-495	—	-500
営業外収支	8	-33	—	-40
税引前純利益	235	-528	—	-540
当期純利益	166	-749	—	-780
受注残	324	58	-82.1	—

2

All Rights Reserved - Advantest Corporation

2009/4/27

○ 2008年度 業績概要

- ・ 2009年2月25日に発表した業績予想を、売上高、利益共に、若干上回る結果となった。

受注高： 501億円 前期比 -69%

売上高： 767億円 前期比 -58%

営業利益： -495億円

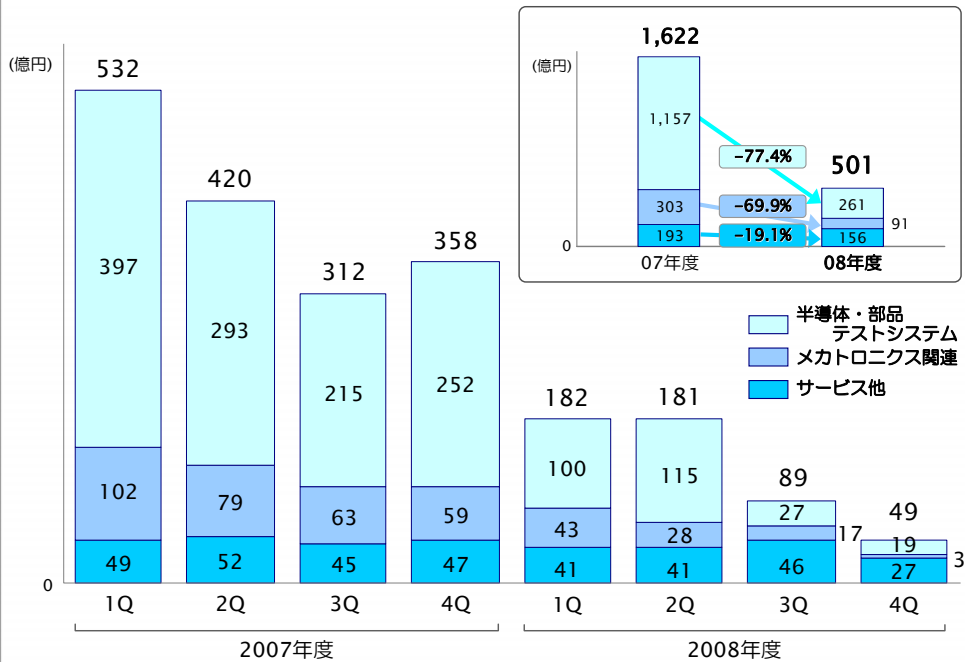
税引前純利益： -528億円

当期純利益： -749億円

- ・ 受注残：
受注の低迷により、前年度末に比べて大幅に減少し、58億円となった。

受注高 事業セグメント別

ADVANTEST.



※合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれております。

All Rights Reserved - Advantest Corporation

2009/4/27

○ 2008年度 事業セグメント別受注高

○ 半導体・部品テストシステム

・前年度比 77%減の 261億円。

・半導体価格の大幅な下落や、半導体製造装置の稼働率の低下により、DRAM向けテスタ、T2000、液晶ドライバIC向けT63シリーズ、デジタル家電用IC向けT65シリーズなど、当社の主力製品の受注が減少した。

○ メカトロニクス関連

・前年度比 70%減の 91億円。

・テスタの需要が低迷した影響で、それに接続される、ハンドラやデバイス・インタフェースの受注も、大幅に減少した。

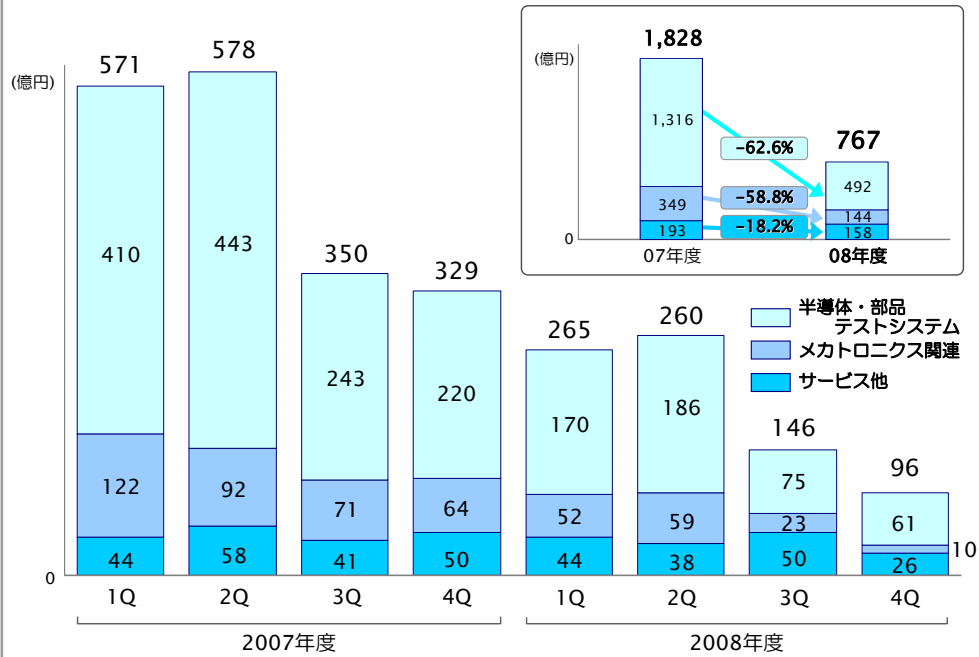
○ サービス他

・前年度比 19%減の 156億円。

・半導体メーカーの稼働率が低下した影響で、保守サービスへの需要が低下した。

売上高 事業セグメント別

ADVANTEST.



○ 2008年度 事業セグメント別売上高

○ 半導体・部品テストシステム

- ・前年度比 63%減の492億円。

※ 主な変動要因については、次ページをご参照ください。

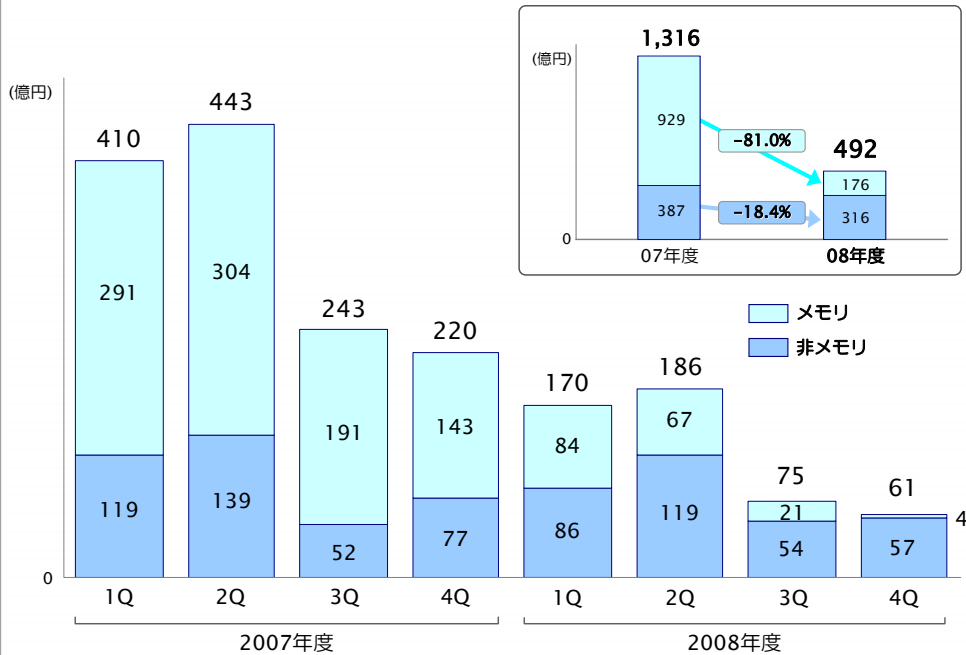
○ メカトロニクス関連

- ・前年度比 59%減の 144億円。

- ・受注と同様、後工程向けを中心にテスト需要が低迷した。

○ サービス他

- ・前年度比 18%減少の 158億円。



○ 2008年度 半導体・部品テストシステムの売上高内訳

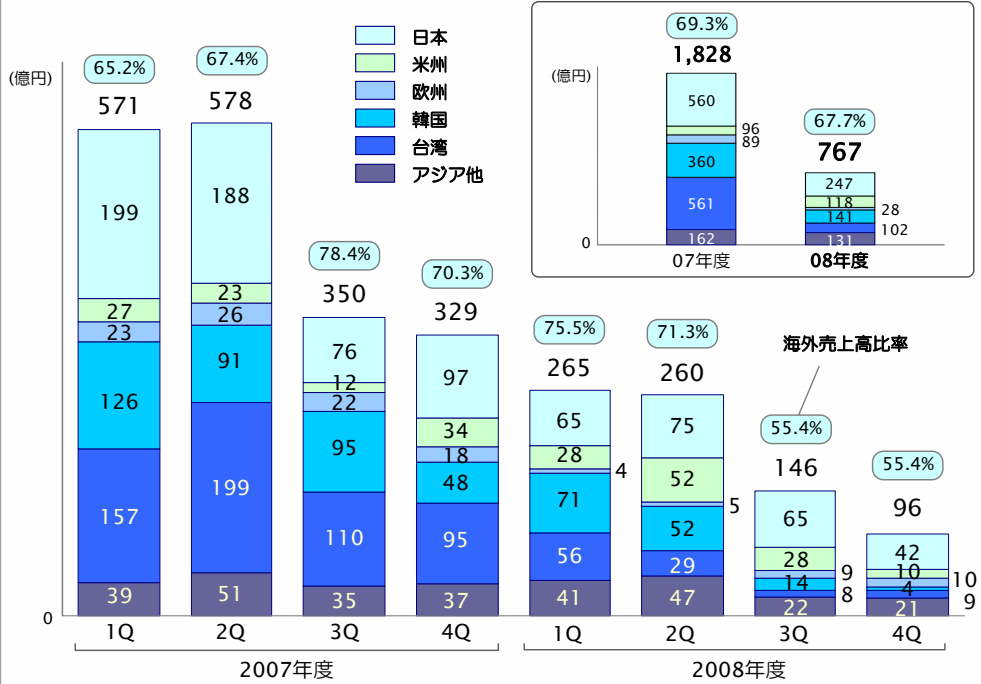
○ メモリ・テスト

- ・前年度比 81%減の 176億円。
- ・半導体価格の大幅な下落や、設備稼働率の低下により、特に、DRAM向けテストは新規投資が抑制された。また、フラッシュ・メモリ向けテストも、前年度に引き続き低調に推移した。

○ 非メモリ・テストは、

- ・前年度比 18%減の 316億円。
- ・年度の前半は、モバイルPC需要の堅調な推移により、T2000の売上が堅調に推移した。しかし、年度の後半には、世界的な消費の減退により、様々な半導体最終製品の需要が低下した。この影響を受け、T65シリーズ、T63シリーズ、さらには、車載用IC向けT77シリーズといった、当社の主力製品の売上が低調となった。

売上高 地域別



○ 2008年度 地域別 売上高

○ 米州での売上高

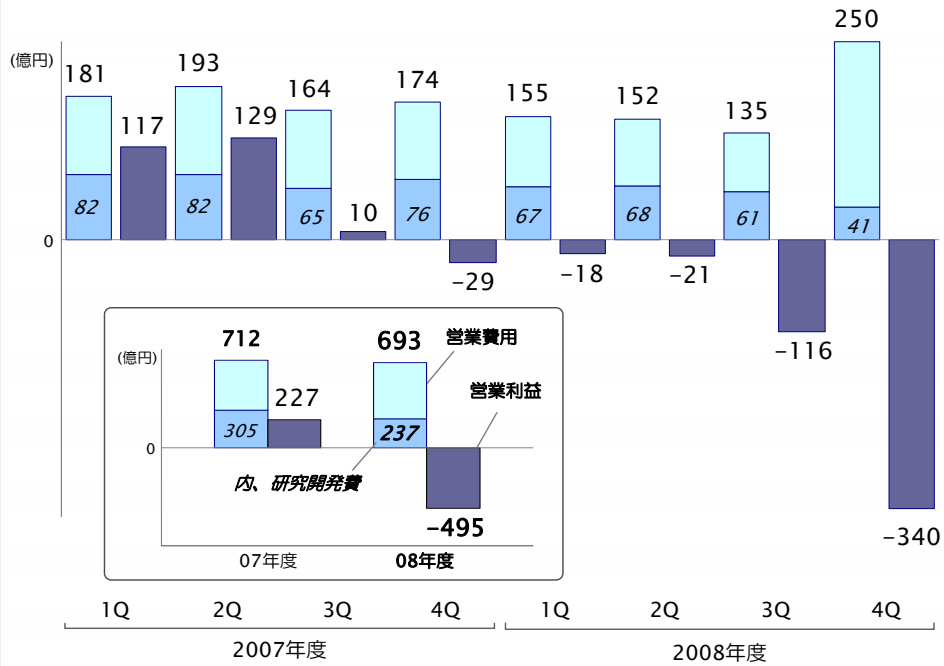
- ・ 前期比で増加
- ・ データ・プロセッシング向けに、T2000のモジュールへの需要が堅調に推移した。

○ 米州以外の地域での売上高

- ・ どこも大幅な売上減少
- ・ 当社の主力製品の需要減少が影響した。

営業費用 および 営業利益

ADVANTEST.



○ 2008年度 営業費用および営業利益

○ 営業費用

- ・ 前年度比 3%減の 693億円。
- ・ この営業費用は、
2008年度に実施した構造改革による費用を含む。

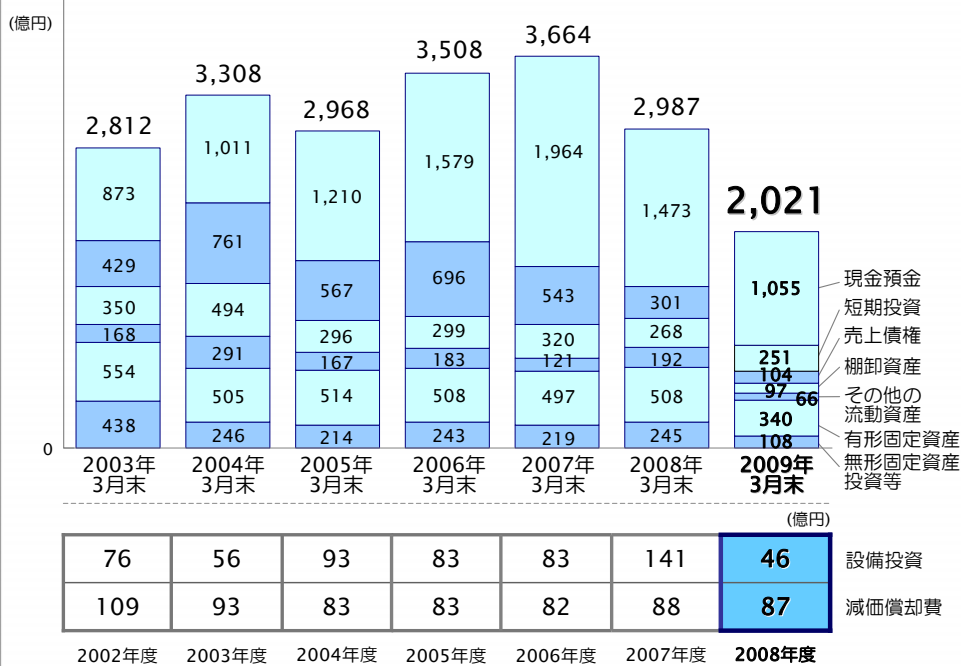
※構造改革の内容については、15ページ目をご参照ください。

○ 営業利益

- ・ 前年度比 722億円減の 495億円。
- ・ 構造改革費用を計上したことと、
売上高が前期に比べて大幅に減少したことが主な要因。

バランス・シート <資産の部>

ADVANTEST.



8

All Rights Reserved - Advantest Corporation

2009/4/27

○ バランス・シート 2009年3月末現在

○ 資産の部

・ 総資産

前年度末比 966億円減の 2,021億円。

・ 現金預金

前年度末比 419億円減の 1,055億円。

しかし、実質的には、

短期投資の 251億円を含め、

約1,300億円の流動性のある資金を有している。

○ 設備投資

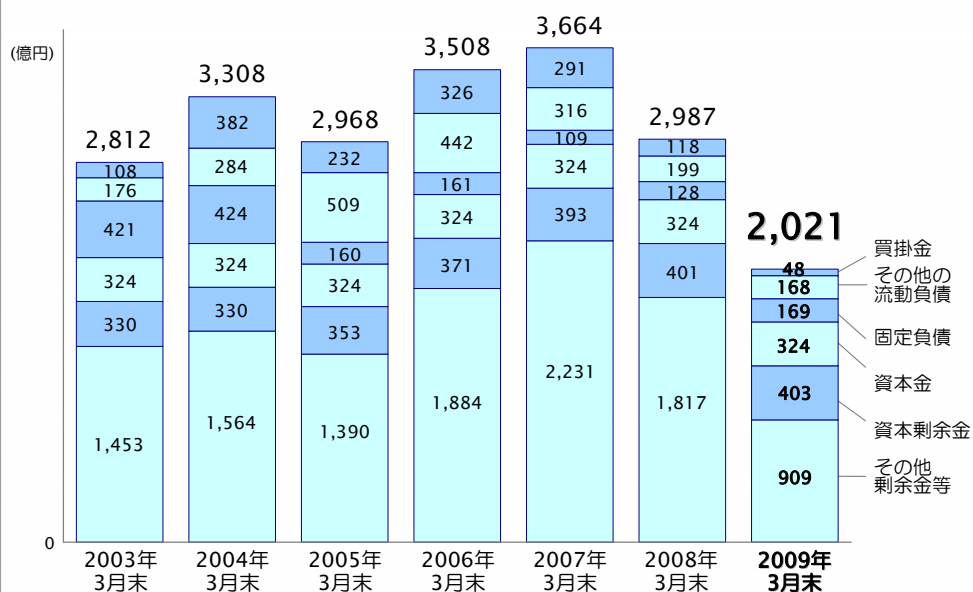
・ 仙台工場建設等で141億円を投資した2007年度と比べ、95億円減の 46億円にとどまった。

○ 減価償却費

・ ほぼ前年度並みの 87億円。

バランス・シート <負債・資本の部>

ADVANTEST.



9

All Rights Reserved - Advantest Corporation

2009/4/27

○ バランス・シート 2009年3月末現在

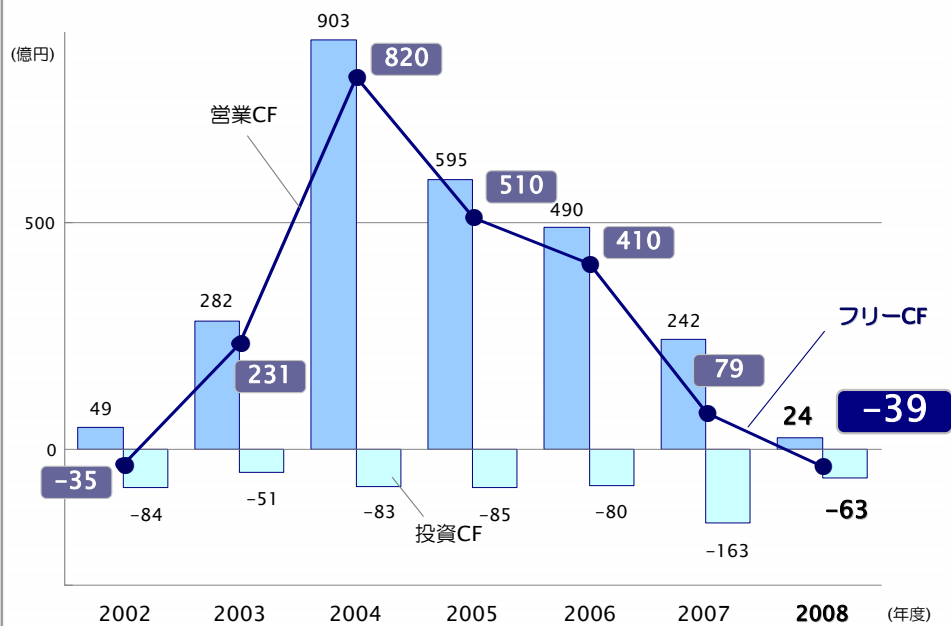
○ 負債・資本の部

・ その他剰余金等

前年度比 908億円減の 909億円。

2008年度の当期純損失、

および、繰延税金資産を取り崩したことが影響した。



10

All Rights Reserved - Advantest Corporation

2009/4/27

○ 2008年度 キャッシュ・フロー (C/F)

- ・ 営業C/F :

24億円の支出。
- ・ 投資C/F :

325億円の支出
 但し、この325億円は、
 短期投資 262億円を含むため、
 実質的には、63億円の支出。
- ・ フリー C/F :

実質ベースでは、
 39億円のマイナス。

株式会社アドバンテスト
構造改革および
今後の見通しについて

2009年4月27日

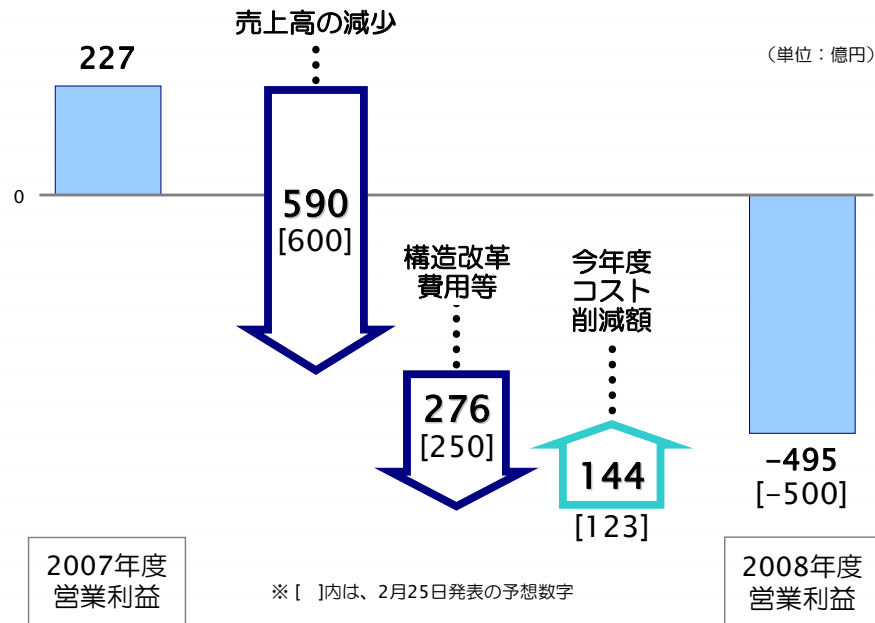
代表取締役 兼 執行役員社長 丸山 利雄

1. 構造改革について

2. 今後の見通しについて

営業利益の変動要因

ADVANTEST.



13

All Rights Reserved - Advantest Corporation

2009/4/27

○ 2008年度 営業利益の変動要因

- ・ 2007年度の営業利益 227億円に対し、
売上高の減少による営業利益の減少 590億円
- 構造改革費用 276億円

○ 構造改革費用の内訳

- ・ 事業の選択と集中による固定資産の減損 138億円
- ・ 急速な市場の悪化に伴う棚卸資産の評価損 87億円
- ・ 早期退職による割増加算金その他 51億円

○ 2008年度中のコスト削減効果

- ・ 144億円。

○ これらの結果、

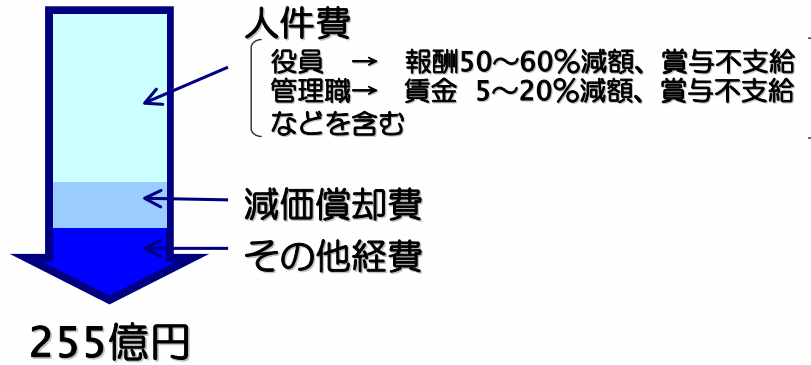
- ・ 2008年度の営業損失は495億円となり、
ほぼ、2月25日に発表した計画どおりとなった。

1. 構造改革について

2. 今後の見通しについて

BEP800億円以下の体制で
2009年度を乗り切る

構造改革による
固定費削減効果



○ 構造改革による固定費の削減効果

- ・ 2009年度については、
人件費、減価償却費、その他経費を合わせて、
総額255億円の効果を見込んでいる。
- ・ すでにBEP売上高800億円以下の体制で、
新年度をスタートした。

マーケットの状況		ADVANTEST.		
半導体市場	ポジティブ	ネガティブ		
	<短期的> ○ 次世代MPUとDDR3の量産開始 ○ 中国市場の拡大 ○ 業界再編→収益回復→投資再開 ○ 在庫調整による半導体価格上昇	<短期的> × 業界再編の遅れ→投資延伸 × ウォン安→価格競争激化 × 中古テストのニーズ拡大 × 稼働率低下→サービス売上減		
	<中期的> ○ 通信の高速、大容量化 →RF-ICの需要増 ○ ハイブリッド自動車の普及 エコ製品の需要拡大 →パワー制御ICの需要増 ○ 微細化、高機能化の進展	<中期的> × BISTなどのテスト簡略化進展 × 半導体のコモディティ化 →半導体価格の大幅な下落		

16

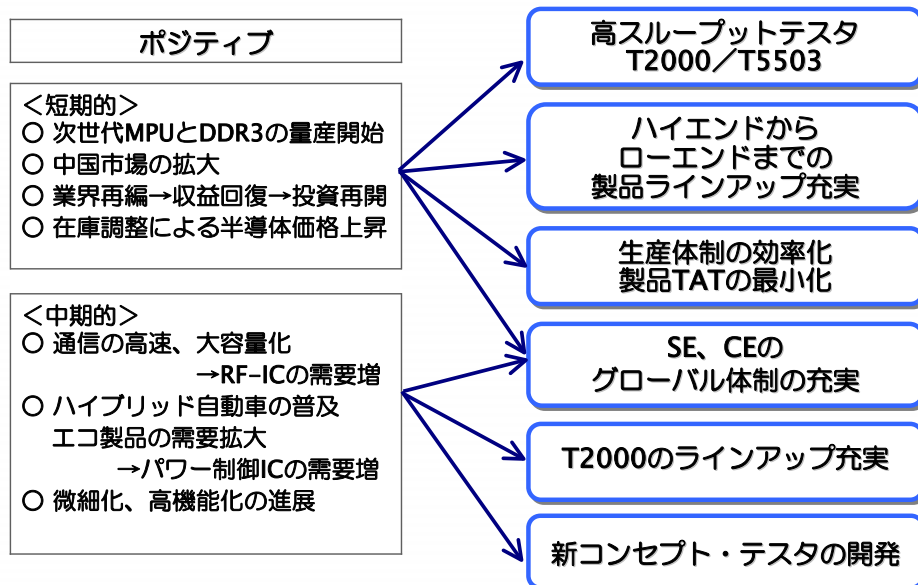
All Rights Reserved - Advantest Corporation

2009/4/27

○ 2009年度以降のマーケットの状況と当社の施策について

○ この表では、

- ・ 2009年度以降の半導体市場について、
当社のビジネスに対して、
ポジティブな要素とネガティブな要素を挙げた。



○ マーケットの現状に対する施策

○ 短期的なポジティブ要素に対する主な施策

- 1) 次世代MPU向け「T2000」、
DDR3の量産用で非常に高スループットな「T5503」を、
市場の立ち上がりに備えてラインアップ済み。
- 2) ローエンド半導体向け新テストを投入。
 - ・アナログICなどに向けたDC測定用テスト、
 - ・デジタルカメラに使われるCMOSセンサ向けテスト、など。

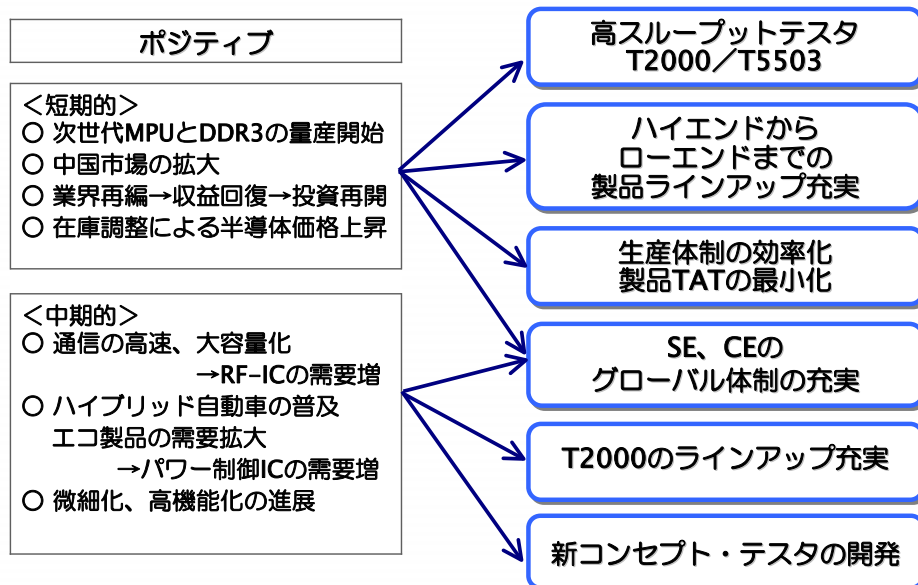
↓

ハイエンドからローエンドまで、
幅広いアプリケーションに対応したソリューションを実現。

- 3) 「事業の選択と集中」の一環として、
生産に関連する事業所の再編にも取り組んでいる。

↓

後補充生産体制をさらに強化して、生産効率を高め、
半導体製造装置業界に特有とも言える、
急激な市場の立ち上がりに対応。



○ 中期的なポジティブな要素に対する主な施策

1) T2000のラインアップ充実

- ・モジュール： 現在約15種類あるラインアップを、その倍の、30種類以上にまで増やす

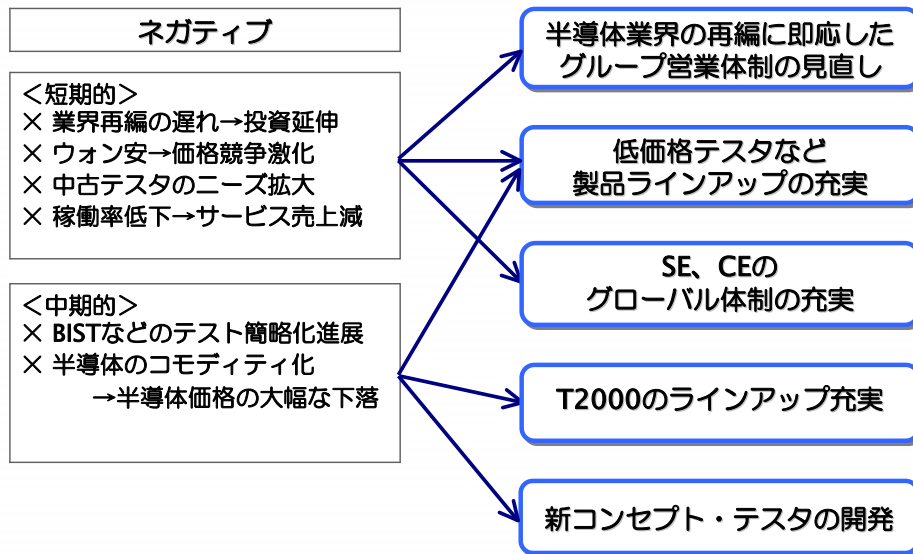


さらに高速化するインターフェース用ICや、ハイブリッド自動車やエコ製品に不可欠なパワー制御ICなど、今後の需要拡大が予想されるアプリケーションに対して、T2000を対応させる。

2) T2000では、この他、

当社の強みでもある多数個同時測定を生かしながら、少量生産向けに、よりコンパクトで、安価なプラットフォームもラインアップする計画。

3) 今後予想される半導体のパッケージ手法の多様化に合わせ、新しいコンセプトのテスト開発にも着手。



○ ネガティブな要素に対する主な施策

- 1) すでに、半導体業界のグローバルな再編に対して、個別の地域ごとに敷いていたテリトリー制から、アカウント・ベースの営業体制へと組織改革を実施した。
- 2) 中古テスト市場の拡大が不可避。
新規テストへの投資が手控えられる一因に。
↓
中古テストの移設作業の依頼や、その後の保守やソフトウェア・ライセンスの再契約など、当社の強みの一つであるサービスへの需要増などのチャンスを着実にビジネスに結び付ける。
- 3) 半導体の用途が、コンピュータ機器以外に、身の回りにあるさまざまな電化製品へと広がったことで、半導体の大量生産、低価格化が進展する。
テストコスト削減へのニーズはさらに強まると予想。
↓
新しいコンセプトのテスト開発を企画
すでに数機種の開発はスタートしている。

○ また、当社では、

半導体以外の計測にも視野を広げて、新規事業の開拓を行っている。一部、すでに商品開発に着手。

ご注意

- ◆ 当社は米国会計基準を採用しております。
- ◆ 将来の見通しに関する記述について
本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているもの又は暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されています。